

請求の範囲

- [請求項1] 第1支持シート上に、熱硬化性樹脂層が積層されてなる保護膜形成用シートであって、
- 前記熱硬化性樹脂層は、半導体ウエハの bumps を有する表面に貼付し、熱硬化させることによって、前記表面に保護膜を形成するための層であり、
- 前記熱硬化性樹脂層の前記第1支持シート側表面の熱硬化前の表面自由エネルギーと、前記第1支持シートの前記熱硬化性樹脂層側表面の表面自由エネルギーとの差が、 10 mJ/m^2 以上であることを特徴とする保護膜形成用シート。
- [請求項2] 前記熱硬化性樹脂層の前記第1支持シート側表面の熱硬化前の水に対する接触角と、前記第1支持シートの前記熱硬化性樹脂層側表面の水に対する接触角との差が 30° 以上である請求項1に記載の保護膜形成用シート。